

# 芯原微电子（上海）股份有限公司

## 关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的 半年度评估报告

芯原微电子（上海）股份有限公司（以下简称“公司”、“芯原”）致力于提高上市公司质量，增强投资者回报，提升投资者的获得感。为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司及全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，公司制定了 2025 年度“提质增效重回报”行动方案，切实履行上市公司的责任和义务，进一步提升公司经营效率，构建良好的资本市场形象，共同促进科创板市场平稳运行，具体内容详见 2025 年 4 月 26 日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》。现将进展情况公告如下：

### 一、聚焦主营业务，提升科技创新能力

#### （一）技术研发

自公司制定 2025 年度“提质增效重回报”行动方案以来，公司持续推进核心技术的研发迭代，以保持技术先进性和核心竞争力，并始终关注市场趋势和技术发展动向，针对目标和关键市场，积极开展新技术的研发，进一步提升公司的科技创新能力和核心竞争力。

公司在持续优化迭代现有核心技术的基础上，于报告期内进一步就生成式人工智能（AIGC）、数据中心、智驾系统、智慧可穿戴设备、物联网这几个关键应用领域，以及 Chiplet 技术进行深入的技术研发和产业化推进。

##### 1) AIGC 应用领域

截至报告期末，芯原全球领先的 NPU IP 已在 91 家客户的 140 余款芯片中获得采用，覆盖服务器、汽车、平板电脑、智能手机、智能家居、可穿戴设备等 10 余个市场领域。目前集成了芯原 NPU IP 的 AI 类芯片已出货近 2 亿颗。芯原最新一代 NPU 架构针对 Transformer 类模型进行了优化，既能高效运行 Qwen、

LLAMA 类的大语言模型，也能支撑 Stable Diffusion、MiniCPM 等 AIGC 和多模态模型。报告期内，芯原超低能耗 NPU 已可为移动端大语言模型推理提供超 40 TOPS 算力，并已在知名企业的手机和平板电脑中量产出货。芯原的 NPU 还与自有的众多处理器 IP 深度集成，形成包括 AI-ISP、AI-Display、AI-VPU、AI-GPU、AI-DSP 在内的众多 AI 加速子系统解决方案。基于其可编程、可扩展特性，以及自有的创新 NeuroBrick 片上硬件加速解决方案，芯原的 NPU IP 还可针对不同应用场景极大优化客户芯片的 PPA 特性。报告期内，芯原的 AI-ISP 芯片定制方案（芯原提供架构设计、软硬协同设计和量产支持）已在知名企业的智能手机中量产出货。公司基于约 20 年 Vivante GPU 的研发经验，所推出的具有自主知识产权的通用图形处理器（GPGPU）可以支持大规模通用计算和 AIGC 相关应用，现已被客户采用部署至各类高性能 AI 芯片中，面向数据中心、高性能计算等应用领域。芯原的 GPU 和 GPGPU-AI IP 在全球范围内已获得多次架构授权，在众多高性能计算产品中获得应用。报告期内，公司面向汽车和边缘 AI 服务器应用推出了可扩展的高性能 GPGPU-AI 计算 IP，提供高算力密度的 AI 加速能力、多芯片扩展支持及 3D 堆叠内存集成能力，并正在与多家领先的 AI 计算客户深度合作，加速推动这些先进技术在实际应用中的规模化落地。报告期内，公司还推出了 ZSP5000 系列 IP。该产品线基于公司第五代经硅验证的数字信号处理器（DSP）架构，采用高可扩展性和低功耗的设计，并针对计算机视觉、嵌入式人工智能等计算密集型应用进行了深度优化，结合架构的可配置能力，该系列 IP 可为各类边缘设备提供兼具能效优势和计算效率的优秀解决方案。

针对 AIGC 产业所面临的安全性和隐私性等问题，芯原还与谷歌合作以支持其新推出的开源项目 Open Se Cura。该项目是一个由设计工具和 IP 库组成的开源框架，旨在加速安全、可扩展、透明和高效的人工智能系统的发展。作为该项目基础设施的一部分，报告期内，芯原开发了多款面向特定应用的平台级解决方案，支持超低功耗空间计算，并提供优质、高效的 AIGC 输入（Token）。目前公司还正在进行基于 Chiplet 架构、面向 AIGC 应用的高性能计算芯片项目的研发。

## 2) 数据中心领域

芯原的视频转码加速解决方案已获得中国前 5 名互联网企业中的 3 家, 以及全球前 20 名云服务提供商中的 12 家的采用。公司面向数据中心应用的视频转码平台项目进展顺利, 第一代平台已于 2021 年第二季度完成研发工作, 并以 IP 授权、一站式芯片定制业务等方式获得多家客户的采用, 已完成适配并陆续量产; 基于芯原 IP 的第二代视频转码平台一站式芯片定制项目(包括软硬件协同验证)已完成, 该平台在原有的技术基础上将不同格式视频转码能力增强到 8K, 增加了对 AV1 格式的支持, 并新增了 AI 处理能力, 此外, 还增加了高性能的多核 RISC-V CPU 和硬件的加密引擎。目前, 第二代平台已成功落地国际领先芯片客户并顺利量产, 公司在此基础上也已进一步拓展了新的客户。

此外, 针对目前不断增长的 AI 视频应用, 以及高质量流媒体和沉浸式体验需求, 报告期内, 芯原公司还推出了新一代低复杂度增强视频编码(LCEVC)视频解码器 IP——VC9000D\_LCEVC。其与芯原的 VC9000D 基础视频解码器协同工作, 可提供高达 8K 超高清的解码能力, 满足高性能、低功耗的视频处理需求, 适用于各类先进多媒体应用。

## 3) 汽车电子领域

公司已耕耘多年, 从座舱到自动驾驶技术均有布局。芯原的 GPU IP 已经在汽车上获得了广泛的应用, 包括信息娱乐系统、仪表盘、车身环视、驾驶员状态监控系统、ADAS、自动驾驶汽车等。多家全球知名的汽车 OEM 厂商都采用了芯原的 GPU 用于车载信息娱乐系统或是仪表盘; 芯原的 VPU IP 已被 2024 年中国造车新势力 Top 8 榜单中 5 家所采用; 芯原的神经网络处理器 IP 也已经获得了多家客户用于其 ADAS 产品。

芯原正在加速各类车规 IP 的认证进程。目前, 公司的第一代 ISP IP 已获得 ISO 26262 汽车功能安全标准认证和 IEC 61508 工业功能安全标准认证; 第二代 ISP 系列 IP 通过了 ISO 26262 ASIL B 和 ASIL D 认证; 芯原的畸变矫正处理器 IP 通过了 ISO 26262 ASIL B 认证; 芯原的显示处理器 IP 获得了 ISO 26262 ASIL B 认证。报告期内, 公司其他 IP, 包括模拟混合和接口类 IP, 也正在逐一通过各类车规认证的进程中。公司的各类处理器 IP 已获众多汽车芯片企业采用。

公司的设计流程已获得 ISO 26262 汽车功能安全管理体系认证，可从芯片和 IP 的设计实现、软件开发等方面，为全球客户满足功能安全要求的车载芯片提供一站式定制服务。此外，芯原还推出了功能安全（FuSa）SoC 平台的总体设计流程，以及基于该平台的 ADAS 功能安全方案，并搭建了完整的自动驾驶软件平台框架。报告期内，公司的车规级高性能智慧驾驶 SoC 设计平台已完成验证，并在客户项目上成功实施，该平台可为自动驾驶和 ADAS 等高性能计算需求提供强大的技术支持。

目前，公司已为某知名新能源汽车厂商提供基于 5nm 车规工艺制程的自动驾驶芯片定制服务，正在积极推进智慧出行领域 Chiplet 解决方案平台研发。基于上述技术布局，芯原正在与一系列汽车领域的关键客户进行深入合作。

#### 4) 智慧可穿戴设备领域

芯原从数年前就开始与该领域领先的企业合作，利用自身低功耗技术方面的优势，积极布局蓝牙耳机、智能手表/手环和基于虚拟现实技术的智能眼镜，并已在芯片和终端产品中验证了芯原面向低功耗应用所打造的 nano 和 pico 系列低功耗 IP 组合。芯原还拥有面向 AR/VR 领域的极低功耗高性能芯片设计平台，可以打造适应不同功率模式的产品，满足超轻量实时在线、低功耗以及全性能的全场景应用。截至报告期末，已有超过 20 家核心智能手表芯片客户采用了芯原的 IP，并广泛应用于市面在售的各类主流智能手表品牌中。芯原正在着力 AI/AR 眼镜的技术平台优化和产业化，除了已为某知名国际互联网企业提供 AR 眼镜的芯片一站式定制服务之外，还有数家全球领先的 AI/AR/VR 眼镜客户正在与芯原进行合作。

芯原以自有的低功耗 IP 为核心基础，结合自身的软件和系统平台设计能力，还推出了一系列从芯片设计到参考应用的一体化可穿戴式健康监测平台级解决方案，可为客户提供含 BLE 协议栈、软件 SDK、算法、智能硬件和应用程序等在内的不同层级的授权和定制设计服务，以期推动可穿戴设备在大健康领域的广泛应用。

## 5) 物联网领域

芯原持续优化和丰富自有的物联网无线连接技术平台。公司持续拓展其在 22nm FD-SOI 工艺上的射频类 IP 产品及平台方案布局，包括支持双模蓝牙、低功耗蓝牙 BLE、NB-IoT、多通道 GNSS 及 802.11ah 等物联网连接技术。目前上述所有射频 IP 已经完成 IP 测试芯片的流片验证，大部分已在客户芯片中与基带 IP 集成，形成完整的连接技术方案，应用于智能家居、智能穿戴、高精度定位等领域。

FD-SOI 技术以其低功耗、高性能、高集成度的优势，在物联网领域获得了广泛应用。公司已深入布局 FD-SOI 技术多年。截至报告期末，公司在 22nm FD-SOI 工艺上开发了超过 60 个模拟及数模混合 IP，种类涵盖基础 IP、数模转换 IP、接口协议 IP 等，已累计向 45 个客户授权了 300 多个/次 FD-SOI IP 核；并已经为国内外知名客户提供了 43 个 FD-SOI 项目的一站式设计服务，其中 33 个项目已经进入量产。报告期内，公司还基于 FD-SOI 的低功耗技术优势，持续开发针对如 Wi-Fi6、卫星通信、毫米波雷达和助听器等应用的技术平台。

## 6) Chiplet 技术

Chiplet 技术及产业化是芯原的发展战略之一，公司已于五年前开始布局 Chiplet 技术的研发。目前，公司正在以“IP 芯片化（IP as a Chiplet）”、“芯片平台化（Chiplet as a Platform）”和“平台生态化（Platform as an Ecosystem）”理念为行动指导方针，从接口 IP、Chiplet 芯片架构、先进封装技术、面向 AIGC 和智慧出行的解决方案等方面入手，持续推进公司 Chiplet 技术、项目的发展和产业化，持续提升公司半导体 IP 授权和芯片定制业务的产业价值，拓展市场空间。

截至报告期末，公司已在基于 Chiplet 的生成式人工智能大数据处理和高端智驾两大赛道实现领跑，目前正在推进基于 Chiplet 架构、面向智驾系统和 AIGC 高性能计算的芯片平台研发项目。目前公司在 Chiplet 领域取得的切实成果包括：已帮助客户设计了基于 Chiplet 架构的 Chromebook 芯片，采用了 SiP（System in Package）先进封装技术，将高性能 SoC 和多颗 IPM 内存合封；已帮助客户的 AIGC 芯片设计了 2.5D CoWos 封装；已设计研发了针对 Die to Die 连接的 UCIe 物理层接口，相关测试芯片已完成流片，正在实验室进行测试，目前进展顺利；

已和 Chiplet 芯片解决方案的行业领导者合作，为其提供包括 GPGPU、NPU 和 VPU 在内的多款芯原自有处理器 IP，帮助其部署基于 Chiplet 架构的高性能人工智能芯片，该芯片面向数据中心、高性能计算、汽车等应用领域。此外，为了应对先进封装技术可能出现的供应和成本等问题，芯原已针对新一代面板级封装（Panel level package）技术进行了先行设计开发，为接下来的规模量产做好了准备。本土封装厂也正在积极布局该封装技术，芯原将与之携手，共同打造更具成本效益且供应安全的先进封装解决方案。

## （二）人才培养

坚持引进和培养优秀人才是公司生存和发展的关键，也是公司持续提高核心竞争力的基础。

根据长期技术发展战略和现有人才储备情况，在引进外部人才方面，公司不仅通过内部推荐、网络招聘等各种方式招募有经验的优秀人才，也通过每年线上及线下校园招聘会、“芯原杯”全国嵌入式软件开发大赛、“芯原杯”电路设计大赛、与各大重点高校联合开展技术和就业指导讲座及企业开放日，搭建“海南大学-芯原智慧医养创新实验室”、“海南大学生物医学工程学院-芯原医疗电子创新实验室”、“浙江大学-芯原智能图形处理器联合研究中心”，以及成立东南大学信息科学与工程学院、南京大学电子科学与工程学院、海南大学计算机科学与技术学院、海南大学生物医学工程学院、海南大学信息与通信工程学院的校外实习实训或教学基地等，以此来吸引并招募国内外顶尖高校的毕业生，为公司持续稳定发展提供人才储备。

在内部人才培养方面，公司不断实行完善有效的培养方案和公开透明的晋升机制，包括通过线上线下的技术和管理培训，专业技术及技术管理双通道发展，提高员工的综合能力；积极营造良好的工作环境，从企业文化、薪酬福利、人才激励等方面提高员工的凝聚力。

截至 2025 年 6 月末，公司研发人员合计 1,805 人，研发人员的占比为 89.31%，研发人员中硕士及以上学历人员占比达 88.76%。公司中国大陆地区具有十年以上工龄的员工占比为 26%，员工平均年龄为 32 岁。基于上述行业及公司特征，公司的研发能力一直保持在较高水平，建立了理论知识扎实、研发实力强、经验

丰富的研发团队，保持了业务的竞争优势，从而打造了高竞争壁垒。

公司拥有丰富且优质的人才和技术储备，并在别的公司不招人、少招人的情况下，芯原仍然逆向思维招收优秀应届毕业生。在 2024 届校招中，近 1 万人参加了全球统一在线笔试，约 1,800 人进入面试环节，公司最终录取了 200 多名应届毕业生，其中，硕士 985、211 院校的占比为 97%，本硕都是 985、211 院校的占比 85%。在 2025 届校招中，公司录取了 100 多名应届毕业生，其中硕士 985、211 院校的占比继续保持在 97%，本硕都是 985、211 院校的占比提升至 89%，超过去年。截至报告期末，近三年入职的应届生累计已申请 71 个专利。得益于公司优异的招聘质量和高效的培训机制，近年招聘的应届毕业生已完成内部培训并对今年已经展开和正要承接的多个芯片大项目提供了必要的人力资源。未来随着行业逐步复苏，公司项目数量增加，这批研发人员将在各自岗位上发挥关键作用。

公司基于对行业周期的判断，一定规模人才储备能够帮助公司在竞争中抢占先机，吸引和培养未来的核心人才，增强企业的竞争力。公司逆势招聘优秀专业人才的战略有助于在行业复苏时快速抓住市场复苏机遇，实现收入增长。

2024 年，公司荣登前程无忧“2024 中国典范雇主”榜单，同时获评“HR 管理团队典范”单项大奖，并在“2025 年人力资源管理杰出奖”评选中荣获“2025 中国杰出雇主”及“最佳培训实践奖”两项殊荣。2025 年 6 月，公司荣获前程无忧“2025 年度大学生喜爱雇主”奖项。此外，公司荣膺猎聘 2024 上海地区年度非凡雇主、牛客网 2024 年度 NFuture 大学生最喜爱雇主，并在第四届“芯雇主”半导体行业人力资源优秀案例评选中荣获“年度雇主”奖。芯原已连续四年被评为芯片行业“最佳雇主”，这充分体现了芯原的软实力。

得益于公司优秀的企业文化，公司人才稳定性保持于较高水平，报告期内，芯原中国大陆地区员工主动离职率为 1.8%，远低于 2025 年上半年度高科技行业整体主动离职率 3.0%（怡安翰威特人力资本调研数据）。

### **（三）资源整合**

报告期内，公司积极开拓 RISC-V 市场，基于芯原的半导体 IP 和芯片定制

平台的技术赋能能力，持续提升芯原在相关领域中的地位与价值，并积极推动 RISC-V 产业生态的发展。

芯原已与赛昉科技、嘉楠科技、先楫半导体等多家 RISC-V 领先企业达成合作。截至报告期末，芯原的半导体 IP 已经获得 RISC-V 主要芯片供应商的 10 余款芯片所采用；此外，芯原已为 20 家客户的 23 款 RISC-V 芯片提供了一站式芯片定制服务，上述项目正陆续进入量产。同时，公司还基于 RISC-V 核推出了包含数据中心视频转码、可穿戴健康监测、物联网无线通信、带硬件安全支持的智能传感 SoC 等多个芯片设计平台，以及基于 RISC-V 核的硬件开发板，上述解决方案正逐步获得客户采用，将有助于推动 RISC-V 技术的商业化进程。

2018 年 9 月，由上海集成电路行业协会推荐芯原股份作为首任理事长单位牵头成立了中国 RISC-V 产业联盟(CRVIC)，截至 2025 年 6 月底，会员单位已达到 204 家。2024 年，芯原联合芯来科技、达摩院共同发起成立了民办非企业单位——上海开放处理器产业创新中心(SOPIC)，该中心专注于推动处理器技术，特别是基于开放指令集架构(如 RISC-V)的研发、生态建设和产业化应用。由中国 RISC-V 产业联盟和芯原共同主办的滴水湖中国 RISC-V 产业论坛已经成功召开了四届，每届会议集中发布 10 余款来自不同本土企业的国产 RISC-V 芯片新品，现已累计推广了 40 多款，广泛应用于消费电子、智能家居、可穿戴设备、通信、汽车、工业控制等多个领域。芯原还连续 4 年举办了基于 RISC-V 技术的“芯原杯”全国嵌入式软件开发大赛。大赛每年吸引来自 40 多所国内高校、累计 650 多支队伍参赛，为 RISC-V 产业发展起到了很好的人才引导和培养作用。

由上海开放处理器产业创新中心于 2025 年 7 月在上海主办的第五届“RISC-V 中国峰会”规模盛大，包括 1 场主论坛、9 场垂直领域分论坛、5 场研习会、11 项同期活动，以及 4500 平方米未来科技展览区，汇聚数百家企业、研究机构及开源技术社区参会。该中心还联合清华大学、北京大学、浙江大学、上海交通大学、复旦大学、西安交通大学、同济大学、山东大学、华东师范大学、电子科技大学、上海大学和上海科技大学这 12 所高校，历时半年精心编撰和发布了《RISC-V 导论：设计与实践》研究生选修课开源课件，助力 RISC-V 专业人才培养。

## 二、优化运营效率，订单再创公司历史新高，连续七个季度保持高位

2025 年第二季度，公司实现营业收入 5.84 亿元，环比增长 49.90%，主要由知识产权授权使用费收入及量产业务收入增长所带动。具体而言，公司 2025 年第二季度实现知识产权授权使用费收入 1.87 亿元，环比增长 99.63%，同比增长 16.97%；2025 年第二季度实现量产业务收入 2.61 亿元，环比增长 79.01%，同比增长 11.65%。

公司潜心投入关键应用领域技术研发，如五年前开始布局 Chiplet 技术及其在生成式人工智能和智慧驾驶上的应用，并持续开拓增量市场和具有发展潜力的新兴市场，拓展行业头部客户。公司在手订单已连续七个季度保持高位，再创公司历史新高，截至 2025 年第二季度末，公司在手订单金额为 30.25 亿元，较 2025 年第一季度末增长 5.69 亿元，环比增长 23.17%。公司技术能力业界领先，并持续获得全球优质客户的认可，2025 年第二季度，公司新签订单 11.82 亿元，单季度环比提升近 150%，支撑未来公司收入增长。2025 年第二季度公司盈利能力持续改善，2025 年第二季度实现归属于母公司所有者的净利润-9,950.51 万元，单季度亏损环比大幅收窄 54.84%。

公司持续深化与各领域头部企业的合作广度与深度，基于芯原的半导体 IP、芯片定制硬件、软件平台的技术赋能能力，持续提升芯原在相关领域中的地位与价值。2025 年 1-6 月，公司半导体 IP 授权服务新增客户数量 3 家，截至报告期末累计半导体 IP 授权服务客户总数量超 450 家；一站式芯片定制服务新增客户数量 6 家，截至报告期末累计一站式芯片定制服务客户总数量 340 家。

公司高度重视业务和市场发展绩效，持续坚定拓展目标市场，履行国际化发展战略，2025 年上半年，公司来源于境外的收入金额 3.98 亿元，占营业收入比重为 40.83%。

自公司制定 2025 年度“提质增效重回报”行动方案以来，公司持续优化研发、存货、应收账款、资金等事项的运营管理，定期与管理层就上述重点运营事项汇报讨论，以增加运营效率。

### 三、再融资顺利完成发行，按计划推进募投项目投入，加强募集资金管理

公司于 2024 年 1 月经 2024 年第一次临时股东大会、于 2024 年 12 月经 2024 年第三次临时股东大会审议通过 2023 年度向特定对象发行股票事项（以下简称“向特定对象发行股票”），公司向特定对象发行股票事项拟募集不超过 180,685.69 万元（含本数），募集资金投资投向为 AIGC 及智慧出行领域 Chiplet 解决方案平台研发项目和面向 AIGC、图形处理等场景的新一代 IP 研发及产业化项目。报告期内，公司成功完成本次向特定对象发行股票事项，发行股票总数量为 24,860,441 股，发行价格为 72.68 元/股，募集资金总额为人民币 1,806,856,851.88 元，扣除本次发行费用（不含税）人民币 26,594,726.32 元后，募集资金净额为人民币 1,780,262,125.56 元。

“AIGC 及智慧出行领域 Chiplet 解决方案平台研发项目”，将针对数据中心、智慧出行等市场需求，从 Chiplet 芯片架构等方面入手，使公司既可持续从事半导体 IP 授权业务，同时也可升级为 Chiplet 供应商，充分结合公司一站式芯片定制服务和半导体 IP 授权服务的技术优势，提高公司的 IP 复用性，有效降低了芯片客户的设计成本、风险和研发迭代周期，可以帮助客户快速开发自己的定制芯片产品并高效迭代，发展核心科技基础，保障产业升级落实。

“面向 AIGC、图形处理等场景的新一代 IP 研发及产业化项目”，将通过研发新一代自主可控的高性能 IP，包括面向 AIGC 和数据中心应用的高性能图形处理器（GPU）IP、AI IP、新一代集成神经网络加速器的图像信号处理器 AI-ISP 等，增强我国自主研发设计具备高性能芯片的能力，为本土集成电路设计企业提供自主可控的 IP 授权，推动国内集成电路设计产业高质量发展，同时致力于打造完善的应用软件生态系统，满足下游市场大模型研发对高性能、低能耗的技术需求。

公司严格管理募集资金使用，确保募集资金按照既定用途得到充分有效利用。2025 年 6 月，公司完成再融资发行工作，相关募投项目研发工作进展顺利。

## **四、完善内部控制体系建设，全面梳理《公司章程》及现有内部控制制度，取消监事会并完成换届选举**

自公司制定 2025 年度“提质增效重回报”行动方案以来，公司不断健全公司治理结构，对内控体系进行完善，提升公司治理水平，为公司股东合法权益的保护提供有力保障。

2025 年 7 月，根据《中华人民共和国公司法》和《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司完成监事会取消工作，监事会的职权由董事会审计委员会行使。此外，公司全面梳理《公司章程》及现有内部控制制度，完成了《公司章程》修订并制定及废止公司部分内部管理制度。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 15 日于上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《关于取消监事会、调整董事会人数、变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记暨修订、制定及废止公司部分内部管理制度的公告》（公告编号：2025-028）。

2025 年 7 月，公司完成了第三届董事会换届选举及公司高级管理人员聘任工作。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 31 日于上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-041）。

## **五、制定《市值管理制度》，完成实施回购股份方案，加强与投资者的沟通**

公司始终重视与广大投资者的交流互动，并致力于维护良好的投资者关系。公司于 2025 年 4 月 25 日召开第二届董事会第二十一次会议暨 2024 年年度董事会，审议通过了《关于制定公司<市值管理制度>的议案》。公司基于《市值管理制度》，切实推动公司提升投资价值，践行“以投资者为本”的发展理念，诚实守信、规范运作、稳健经营，在此基础上做好投资者关系管理，增强信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资价值合理反映公司质量。

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，增强投资者对公司的投资信心，结合公司经营情况及财务状况等因素，公司于 2025 年 7 月审议并完成了以集中竞价交易方式回购部分公司股份，回购股份数量 28.70 万股，回购金额 2,483.19 万元，回购价格区间 85.80 元/股~87.00 元/股。上述回购股份将在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励，并在公司披露股份回购实施结果公告日之后的三年内予以转让。

自公司制定 2025 年度“提质增效重回报”行动方案以来，公司于 2025 年 4 月 29 日上证路演中心平台召开了 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，并将于 2025 年 8 月 25 日召开 2025 年半年度业绩说明会。截至本报告披露日，公司 2025 年内已举办了 16 场投资者关系活动，完成 14 个“上证 e 互动”平台问题回复，通过各种形式与投资者积极沟通，加深投资者对于公司经营情况的了解，增强投资者对公司的认同感，增进交流互信，树立市场信心。

此外，公司于 2025 年 4 月 26 日发布了《2024 年社会责任报告》，向社会公众及投资人全面展示公司积极履行 ESG 管治的责任和义务，在社会责任、员工关怀等方面的表现，有助于市场更充分的了解公司经营和发展情况。

## 六、完善投资者回报机制

公司将持续根据公司于 2023 年 12 月制定并披露的《未来三年(2023 年-2025 年) 股东回报规划》，综合考虑公司未来战略发展目标的基础上，兼顾各类股东意愿，结合公司的盈利情况和现金流量状况、经营发展规划及企业所处的发展阶段、资金需求情况、社会资金成本以及外部融资环境等因素，依据《公司章程》的要求，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，并对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的合理性、连续性和稳定性。公司将根据经营情况与发展规划，严格执行分红政策，在符合条件的情况下积极推动对广大股东的利润分配以及现金分红，强化对投资者的回报机制。

## 七、强化管理层与股东的利益共担共享约束并强化“关键少数”的责任

公司推崇全员持股理念，重视员工的归属感，鼓励员工和公司共发展。公司于科创板上市后，推出了 2020 年限制性股票激励计划及 2022 年限制性股票激励计划，通过实施上述股权激励计划，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，促进公司核心人才队伍的建设和稳定，从而有助于公司长远发展，维护股东权益。2025 年内，公司完成 1 次限制性股票归属工作，归属股份 497,750 股。

公司始终重视“关键少数”在公司生产经营过程中的重要作用，持续强化“关键少数”的履职责任。2025 年 7 月，公司完成了第三届董事会换届选举及公司高级管理人员聘任工作，公司将督促“关键少数”积极参与上交所等监管机构举办的各种培训，加强学习证券市场相关法律法规，熟悉证券市场知识，及时传达最新监管精神、处罚案例、市场动态等信息，强化“关键少数”合规意识，推动公司持续规范运作。

公司制定了科学合理的薪酬机制，董事会薪酬与考核委员会负责研究并监督对公司高级管理人员的激励、考核和方案实施。2025 年度，董事会薪酬与考核委员会将结合公司经营情况、战略发展等目标的综合完成情况对公司高级管理人员进行绩效业绩考核，确保高级管理人员的薪酬水平与工作职责、业绩考核以及公司经营情况等指标合理挂钩，以强化管理层与股东的利益共担共享。

## 八、其他措施

综上所述，报告期内，公司严格执行此前制定的《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》，并取得了一定进展。公司将持续对 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的具体措施进行评估，并及时履行信息披露义务。未来，公司将进一步提升经营管理水平，继续深耕主营业务，强化核心竞争力，巩固市场地位，优化盈利结构；公司管理层也将一如既往地致力于提升公司业绩和 market 价值，为股东创造更多的投资回报。

本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

芯原微电子（上海）股份有限公司董事会

2025年8月22日